



# SAC305

## ALLIAGE S-Sn96,5 Ag3,0 Cu0,5

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alliage de brasage ternaire sans plomb, utilisé dans l'industrie électronique mais aussi dans des applications médicales et alimentaires.

- \* Le plus bas joint de fusion des alliages sans plomb habituels : 217°C.
- \* Alliage le plus utilisé parmi les sans plomb ternaires SAC (SnAgCu) sur le plan international
- \* Très bonne résistance mécanique.
- \* Alliage brillant, bonne capillarité.
- \* Bonne conductibilité électrique.
- \* Bon mouillage sur les surfaces habituelles, mais limitée sur Cu.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Teneur Étain, Sn : .....	Restant
Teneur Cuivre, Cu : .....	0.2 % à 0.6 %
Teneur Argent, Ag : .....	3,0 % à 3,4 %
Intervalle de fusion : .....	Eutectique à 217°C
Masse spécifique : .....	7.3
Résistance mécanique : .....	Dureté Brinell : 14.8 H.B.
Conductibilité électrique : .....	14 % IACS
Résistivité électrique : .....	12.3 $\mu \Omega$ cm

### ASSURANCE QUALITÉ

Chaque livraison est identifiée par son lot de fabrication muni du certificat d'analyse correspondant.

**Composition chimique correspondant à celle de stocks disponibles à la date de l'édition et pouvant être sujette à modification. Ces teneurs ne sont qu'indicatives et ne sauraient engager contractuellement TELAMETAL**